



2017年12月期 決算与中期经营计划说明资料

株式会社RS Technologies



东京证券交易所主板上市企业
股票代码：3445

公司概况 P. 3

公司概况

历史沿革

现在的RS Technologies

董事长方永义的优势

中期经营计划 P. 8

RS Technologies追求的世界

再生晶圆业务（1）

再生晶圆业务（2）

涉足产品级硅片业务

中国的半导体政策

设备投资计划与业务计划

中期经营计划概要

业绩动向 P. 16

2017年度决算概要

各部门动向

营业利润增减因素分析

财务报表

2018年度预测

中长期经营方针

Appendix P. 23

业绩变化情况

主要财务报表

公司概况



公司概况

半导体再生晶圆的市场份额高达30%的领军企业。通过涉足中国的产品级硅片业务，扩大业务范围，力求从再生晶圆专业厂商跃升为产品级硅片制造商

公司名称	株式会社RS Technologies
成立	2010年12月10日
经营理念	“爱护地球环境，赢得世界各地客户的信赖，坚持不懈地创造挑战。”
业务内容	电子材料、电子器械元件、通信器械元件材料の制造、加工、再生、销售，太阳能发电业务。旧半导体设备的收购和销售业务。半导体材料和元件的销售。半导体硅片制造的技术咨询服务。
总部地址	东京都品川区大井1-47-1 NT BIRU 12F
三本木工厂	宫城县大崎市三本木音无字山崎26-2
资本金	641,850千日元（截至2017年12月底）
董事长	方永义
员工人数	600人（截至2017年12月底 正式员工443人，派遣员工157人）
合并子公司	艾尔斯半导体股份有限公司（台湾）2014年2月成立 资本金 NT \$300 million
	北京有研RS半导体科技有限公司（北京）2018年1月成立 注册资本金 US \$138 million



继承RASA工业的硅片再生业务，于2010年创业。再生晶圆业务位居世界榜首。2015年在东京证券交易所创业板上市，2016年在东京证券交易所主板上市。2018年使中国的大型产品级硅片制造商成为合并子公司

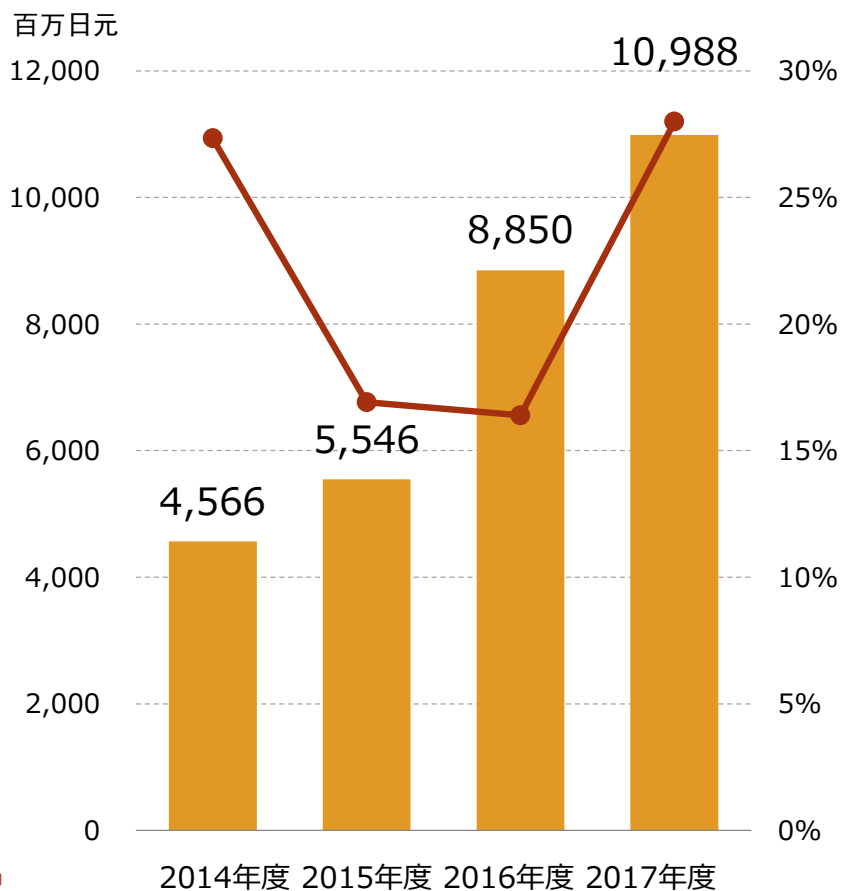
2010年12月	在东京都品川区，以硅片再生业务（自1884年1月起由RASA工业开展业务）为主要业务，成立株式会社RS Technologies
2011年1月	在三本木工厂开工（雇用RASA工业株式会社的一部分离职员工）
2011年11月	三本木工厂通过UKAS“ISO9001:2008”（质量管理体系）认证审核
2013年3月	开始机械销售业务
2013年10月	在三本木工厂开始太阳能业务
2014年2月	在台湾成立子公司——艾尔斯半导体股份有限公司（现为合并子公司）
2015年3月	在东京证券交易所创业板上市
2015年6月	引进最先进设备（可再生450mm晶圆）的三本木工厂和第8工厂竣工
2015年10月	第13届“德勤会计师事务所日本技术 Fast50”中创下1299.53%的增长率记录，荣获第三名
2015年12月	艾尔斯半导体股份有限公司（现为合并子公司）的台南工厂竣工
2016年9月	变为东京证券交易所主板上市企业
2017年12月	与北京有色金属研究总院和福建仓元投资有限公司签订三家公司的合资合同
2018年1月	成立北京有研RS半导体科技有限公司，将中国产品级硅片制造商有研半导体材料有限公司变为合并子公司
2018年5月	计划获得株式会社Union Electronics的股份



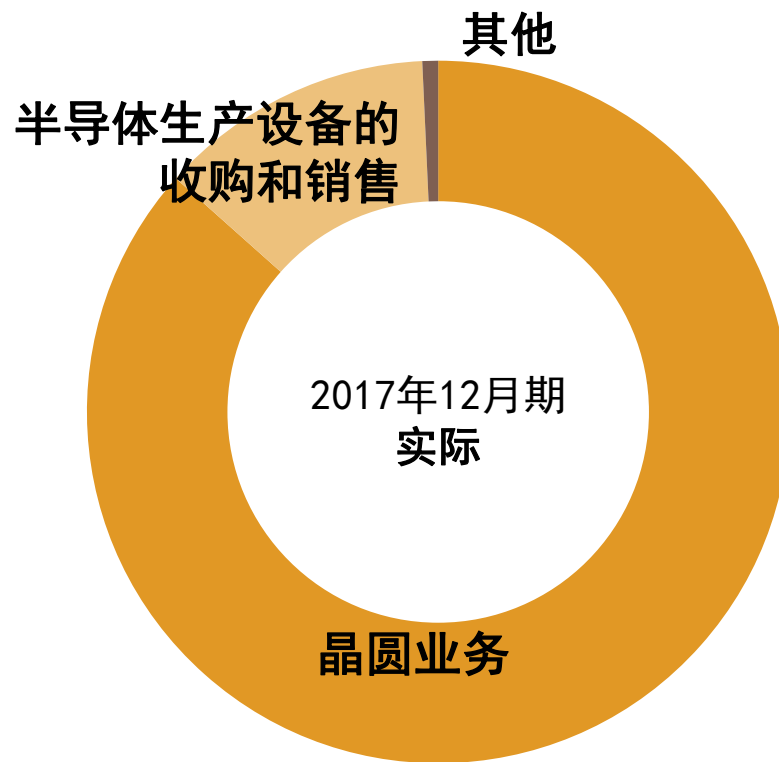
现在的RS Technologies

以再生晶圆为中心的晶圆业务占到销售额的五分之四。此外还开展以中国为主要对象的半导体生产设备的收购和销售、太阳能业务等

合并销售额与营业利润率



各部门业绩



董事长 方永义的优势

董事长总经理方永义的优势是充分发挥20多年来在日本积累的见识和自己拥有的网络，面向全球的营销能力、人际关系、合作能力及资金实力。

方永义麾下集结了高科技、金融等广泛领域的专业“人财”。



前排中央为方永义（2016年9月摄于东京证券交易所）

方 永义

1970年出生 中国福建省人
城西国际大学研究生院 结业

擅长领域：
并购、业务合作（过去成功并购了超过10家企业）

1998年 成立永辉商事
2006年 就任永辉商事总经理
2010年 成立本公司并就任总经理（现任）

座右铭：事在人为

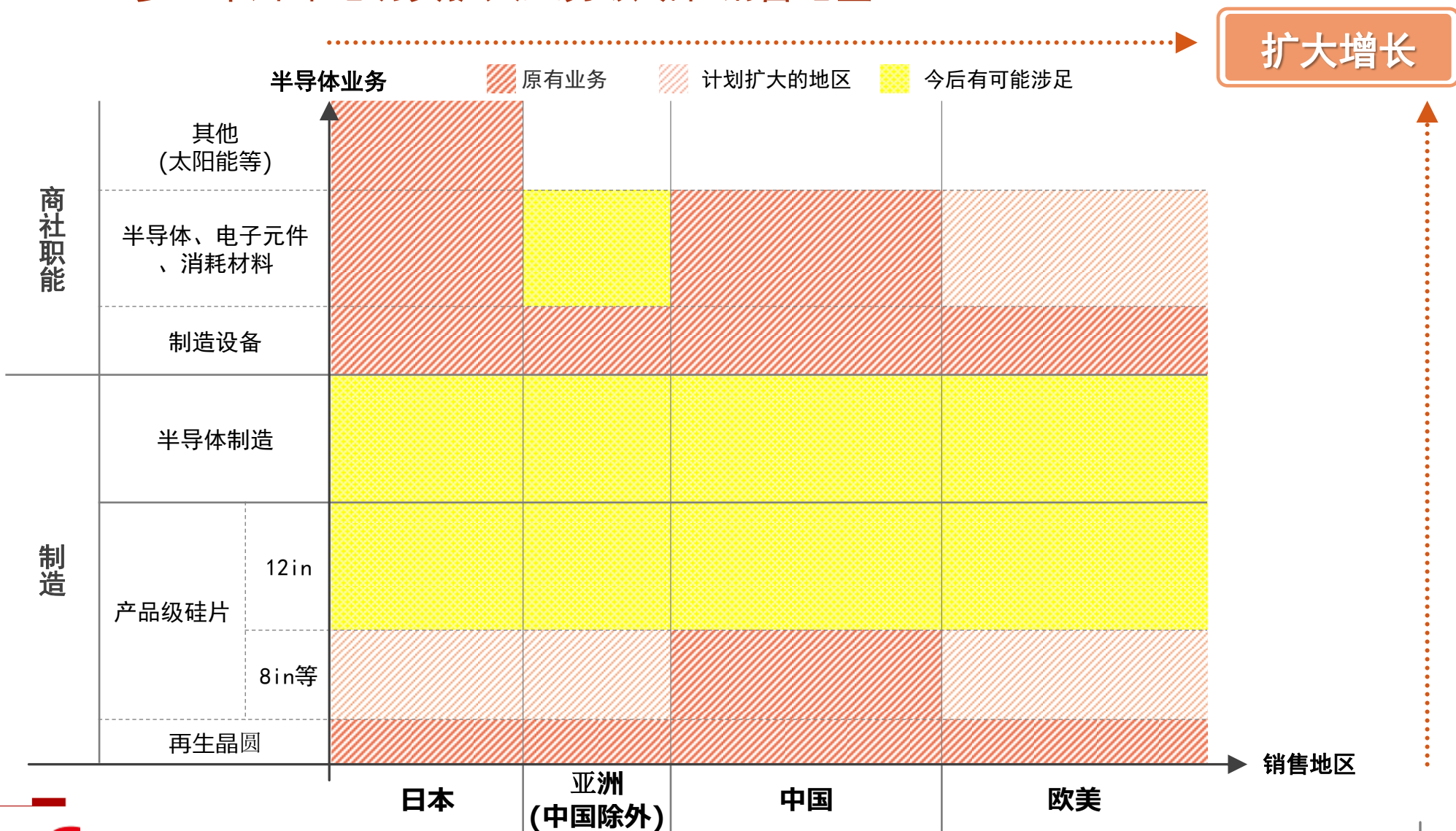
补充：

高中毕业后来日。拥有日本国内外的20多家公司的投资经验。除半导体业务外，还有基金、贸易、酒店、IT业务、农业等各种行业的投资经验。以“日本的制造服务世界第一”为信条，奔走于世界各地，向全球推广日本的制造服务。

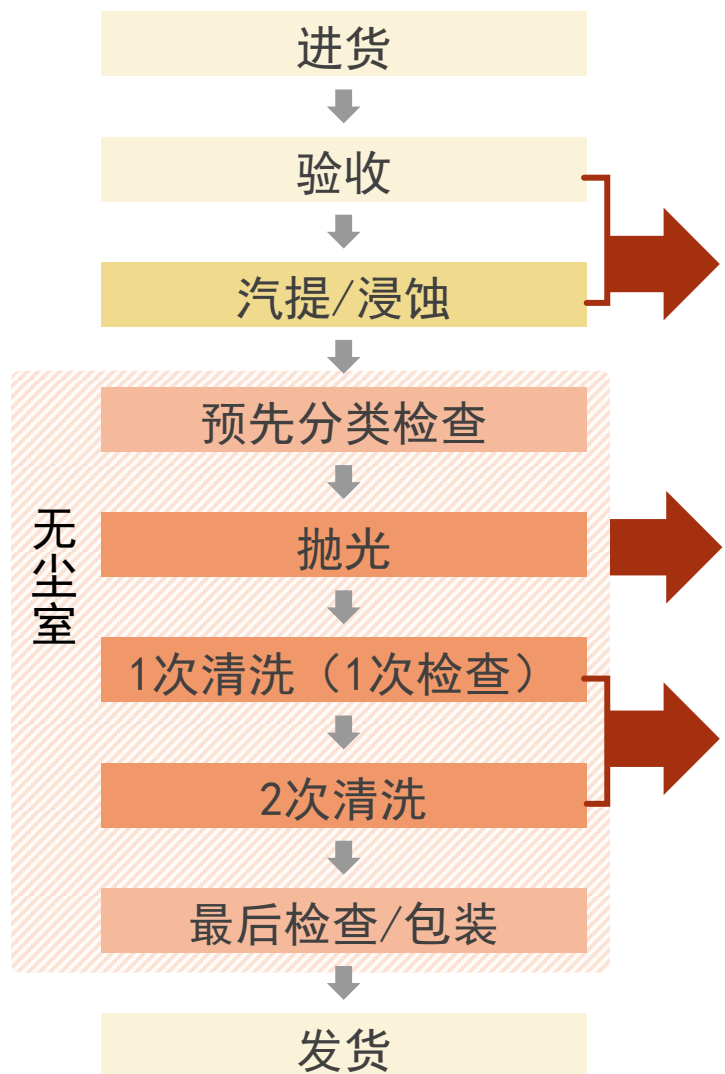
中期经营计划



一步一个脚印地切实扩大业务领域和销售地区



再生晶圆业务(1)



优势 1

可以剥离所有薄膜

- 采用化学方法去除，可以尽量减少表面损伤

▶ 再生次数较多

▶ 可以进一步降低成本

继承RASA工业（化学）的非凡技术



通过研磨（抛光）消除表面的伤痕和凹凸，使其平滑

优势 2

去除金属杂质

- 通过清洗来去除晶圆表面的细微灰尘和污垢

去除金属杂质

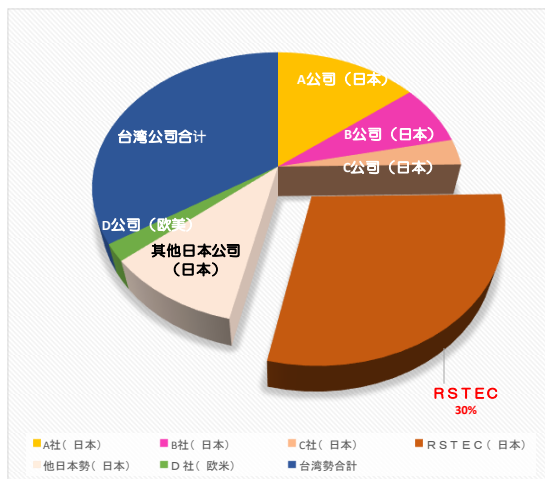
尤其擅长清除铜（Cu）污染



再生晶圆业务(2)

扩大再生市场的本公司份额

300mm再生市场的本公司份额



通过台湾的新建和三本木的扩建，生产能力得到提高，现在的市场份额升至30%

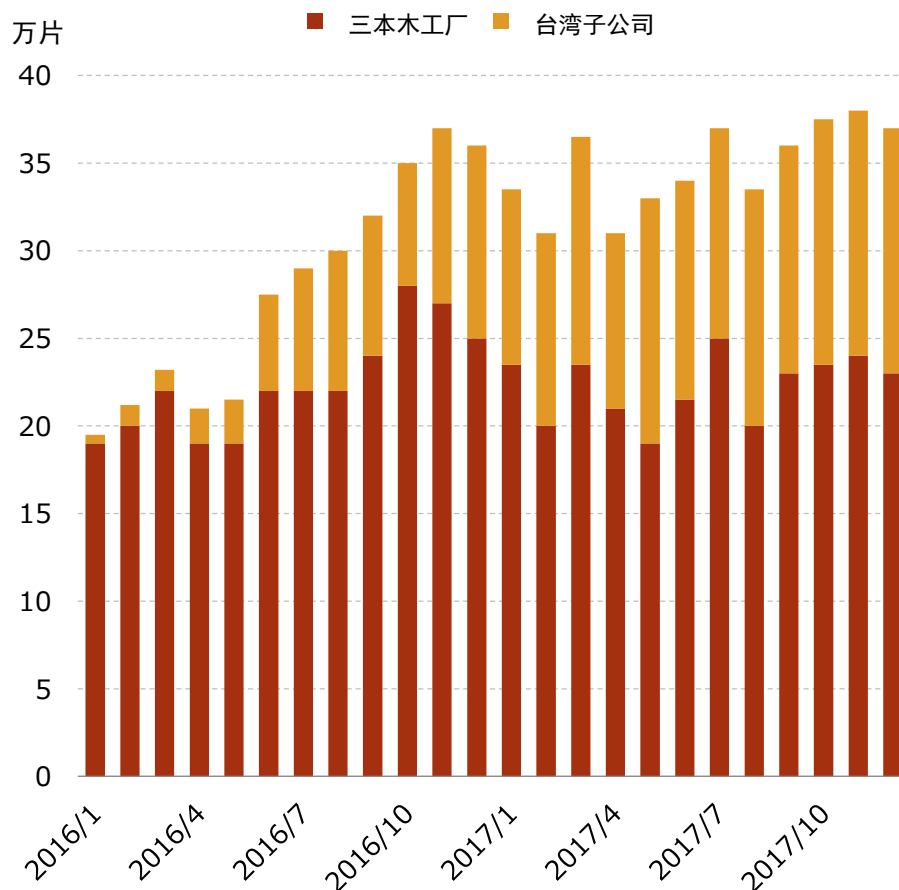
采用了多种方法，如利用两家工厂的原有设备进一步提高生产能力，利用三本木的闲置工厂，业务合作和并购等

到2018年使市场份额扩大至40%

	2015年上期	2015年下期	2016年	2017年	2018年目标
本集团公司生产能力	18万片	24万片	28万片	30万片	≥40% 目标
本集团公司市场份额	19%	24%	29%	30%	

三本木工厂与台湾子公司的发货变化情况

三本木工厂与台湾子公司的300mm晶圆发货片数变化情况



涉足产品级硅片业务

与中国中央政府直属企业——北京有色金属研究总院（现在的有研科技集团有限公司）成立合资公司。作为内资企业（中国的本土企业）开展半导体业务



本公司与有研的协同效应

优势1

在中国国内销售时，发挥内资企业的优势

优势2

享受中国半导体优惠政策

优势3

利用RS的全球性销售网络向全世界客户销售

优势4

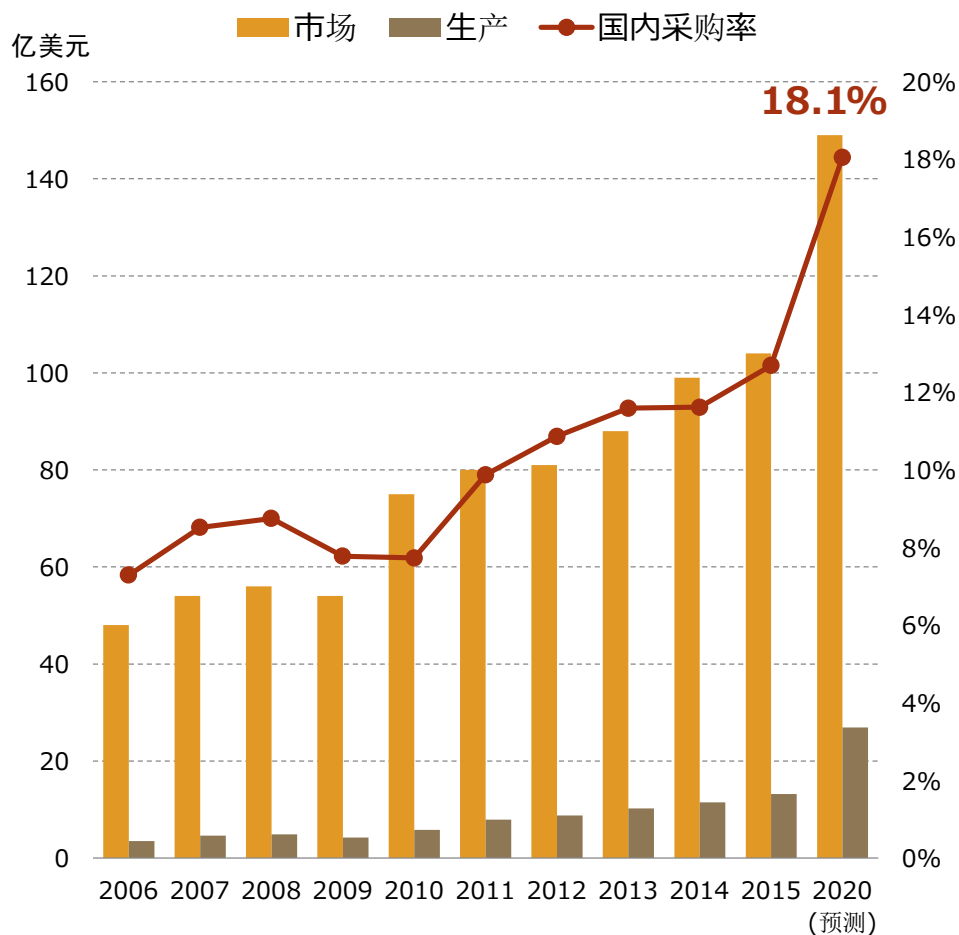
充分利用RS的再生加工技术

- 本公司拥有长达30多年的丰富知识经验



中国的半导体政策：以提高国产化率为目标

中国的半导体市场与生产动向



中国的半导体消费量占到全球消费总量的40%，
增长势头强劲
而国产化率只占其中的10%左右

提高国产化率成为一项重要的政策课题

2014年6月

《国家集成电路产业发展推进纲要》

(国家IC产业发展推进指导方针)

2015年5月

《中国制造2025》

(Made in China 2025)

<以下引用>

China is aiming to improve the self-sufficiency rate for ICs in the nation to 40% in 2020, and boost the rate further to 70% in 2025.

目标是

到2020年国产化率为40%，到2025年为70%

设备投资计划、业务计划

日本

总投资额：4亿日元

- 扩大300mm再生晶圆的生产能力
- 2019年开工

2018年度

2019年度

2020年度

4亿日元

台湾

总投资额：7亿日元

- 扩大300mm再生晶圆的生产能力
- 2019年开工

2018年度

2019年度

2020年度

7亿日元

北京

总投资额：94亿日元

- 扩大200mm再生晶圆的生产能力

2018年度

2019年度

2020年度

42亿日元

52亿日元

- 亿日元

中国半导体优惠政策

1. 获得新建工厂用地时给予补贴。
2. 提供工厂建设资金。
3. 按总投资金额的一定比例给予补贴。
4. 对有息债务利息给予补贴。
5. 所制造的产品级硅片在中国国内优先销售。

第1次计划

200mm产品级硅片

2018年

5万片



2021年

20万片

投资期限

2019年~2020年

自2020年起依次开工



中期计划（4年）概要

扩大业务范围，力求从再生晶圆专业厂商跃升为产品级硅片制造商

最后年度（2021年）的目标

成为中国半导体市场的硅片领军企业

确保再生晶圆市场的牢固地位

(百万日元)	2017年12月期 实际	2018年12月期 计划	2019年12月期 计划	2020年12月期 计划	2021年12月期 计划
销 售 额	10,988	20,993	21,000	25,000	29,000
营 业 利 润	3,075	3,891	3,600	4,800	6,300
营 业 利 润 率	28.0%	18.5%	17.1%	19.2%	21.7%
经 常 性 净 利 润	3,223	3,897	3,900	4,700	6,200
经 常 性 净 利 润 率	29.3%	18.6%	18.6%	18.8%	21.3%
母 公 司 拥 有 人 应 占 溢 利	2,210	2,585	2,500	2,900	3,800
每 股 股 利 (日 元)	199.31	208	201	233	306

※硅片的销售单价以2018年期初单价为准。

※半导体生产设备的收购和销售业务，2018年、2019年为预计销售额，不包括2020年以后。

※每股股利包括2018年3月6日通过决议的公募增资部分，但是不包括0. A部分。

业绩动向



2017年度决算概要

再生晶圆市场的外部经营环境，半导体（Foundry、Memory）以及硅供不应求，发展前景向好。

总的来说，本公司的经营环境非常稳定。

(百万日元)	2016年12月期 (2016年1月~12月)	2017年12月期 修订预算 (2017年1月~12月)	2017年12月期 (2017年1月~12月)	环比	完成率
销 售 额	8,849	9,450	10,988	124.2%	116.3%
营 业 利 润	1,557	2,550	3,075	197.4%	120.6%
营 业 利 润 率	17.6%	26.9%	28.0%		
经常 性 净 利 润	1,450	2,650	3,223	222.2%	121.6%
经常 性 净 利 润 率	16.3%	28.0%	29.3%		
母 公 司 拥 有 人 应 占 溢 利	869	1,630	2,210	254.1%	135.6%
每 股 股 利	79.98日元	145.87日元	199.31日元	+119.33日元	136.6%



各部门和公司的动向

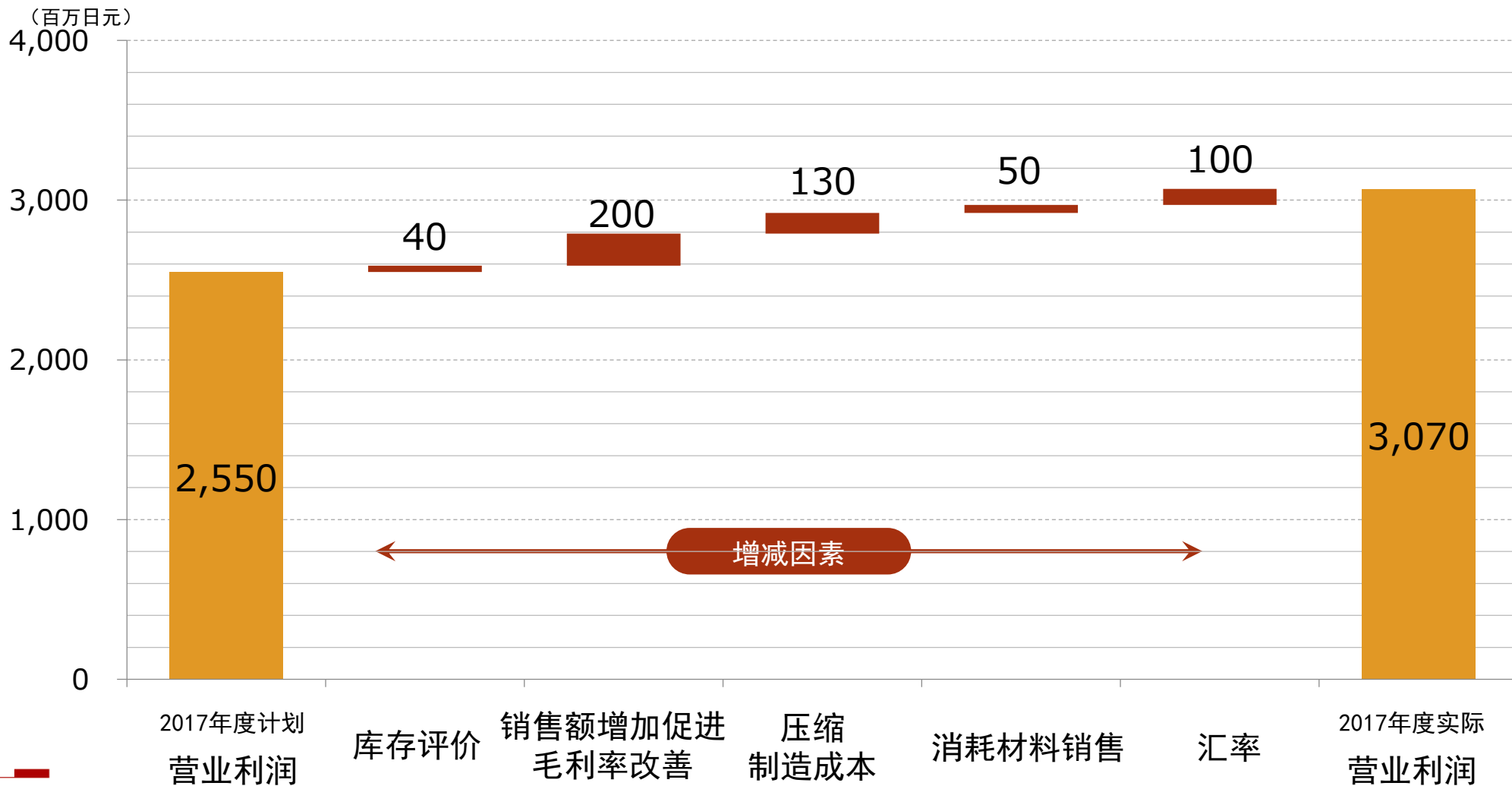
各部门 (百万日元)	晶圆业务	半导体生产设备的 收购和销售	其他	合并合计
销 售 额	9,513	1,395	79	10,988
营 业 利 润	3,461	129	△516	3,075
营 业 利 润 率	36.4%	9.2%	—	28.0%

各公司 (百万日元)	RS	台湾子公司	合并抵销	合并合计
销 售 额	8,503	2,647	△162	10,988
营 业 利 润	2,139	885	50	3,075
营 业 利 润 率	25.2%	33.5%	—	28.0%



营业利润增减因素分析

- 因为单价上升，部分客户的毛利率得到改善。
- 与当初计划汇率（1美元=107日元）相比，日元趋向贬值，有助于提高利润。



财务报表

合并资产负债表

(百万日元)	2016年12月期	2017年12月期
资产部分		
流动资产	5,525	7,625
现金及存款	1,952	3,243
应收票据及应收账款	2,727	3,141
商品及产品	361	463
固定资产	5,333	4,843
有形固定资产	5,152	4,674
无形固定资产	23	19
投资等资产	158	149
资产合计	10,859	12,468
负债部分		
流动负债	3,000	3,384
应付票据及应付账款	283	398
有息负债	1,537	1,275
固定负债	4,317	3,291
长期借款	3,620	2,767
负债合计	7,317	6,676
净资产部分		
净资产	3,541	5,792
负债与净资产合计	10,859	12,468

现金流量

(百万日元)	2016年12月期	2017年12月期
营业活动的现金流量	964	2,744
投资活动的现金流量	△776	△202
财务活动的现金流量	△91	△1,252
现金及现金等价物的换算差额	13	△87
现金及现金等价物的增减额	110	1,201
现金及现金等价物的期初余额	1,603	1,714
现金及现金等价物的期末余额	1,714	2,916



2018年度预测

在中国的产品级硅片业务（有研半导体材料有限公司）的帮助下大幅增收。产品级业务的利润率相对低于再生业务，因此预计环比会下降。

(百万日元)	2017年12月期 实际 (2017年1月~12月)	2018年12月期 预测 (2018年1月~12月)	环比
销 售 额	10,988	20,993	+10,005
营 业 利 润	3,075	3,891	+816
营 业 利 润 率	28.0%	18.5%	△9.5%
经 常 性 净 利 润	3,223	3,897	+674
经 常 性 净 利 润 率	29.3%	18.6%	△10.7%
母 公 司 拥 有 人 应 占 溢 利	2,210	2,585	+375
每 股 股 利	199.31 日元	208.00 日元	+8.69 日元
年 度 股 利	5 日元	未定	—

汇率前提

2017年12月期 实际 1美元=113日元。 1新台币=3.7日元。

2018年12月期 预算 1美元=111日元。 1新台币=3.5日元。 1人民币=17日元。

1. 扩大再生晶圆市场的本公司份额

- ①. 提高生产能力
- ②. 吸收增长的需求
- ③. 开拓潜在的再生市场

2. 参与中国半导体市场

- ①. 提高200mm产品级硅片的生产能力
- ②. 涉足300mm产品级硅片
- ③. 在中国经营靶材（半导体元件）
- ④. 在中国扩大半导体生产设备及其相关资材的销量

Appendix

提供长期数据



业绩变化情况

(百万日元)	2012年12月期	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期
销售额	1,433	3,475	4,566	5,545	8,849	10,988
销售利润总额	156	1,173	1,820	1,872	2,516	4,345
销售及管理费	186	471	654	791	958	1,269
营业利润	△31	703	1,166	1,081	1,557	3,075
经常性净利润	44	819	1,247	937	1,450	3,223
本期净利润	50	525	664	304	869	2,210
设备投资	32	347	2,901	4,538	209	95
折旧费	72	87	103	326	682	714
研究开发费	1	1	6	11	85	183
员工人数 (正式员工) (人)	126	152	191	265	373	443

业绩变化情况

(百万日元)	2012年12月期	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期
销售额						
晶圆业务	1,433	3,347	4,414	5,107	7,144	9,513
半导体生产设备的收购和销售	—	—	—	372	1,611	1,395
其他	—	127	151	282	93	94
部门利润						
晶圆业务	△31	916	1,444	1,386	1,718	3,461
半导体生产设备的收购和销售	—	—	—	135	221	129
其他	—	27	61	29	66	67
部门资产						
晶圆业务	994	1,337	5,040	6,993	5,620	8,148
半导体生产设备的收购和销售	—	—	—	42	1,132	1,300
其他	—	396	382	533	556	532



主要财务报表

(百万日元)	2012年12月期*	2013年12月期*	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期
资产部分						
流动资产	745	1,811	2,759	3,892	5,525	7,625
现金及存款	56	397	1,190	1,842	1,952	3,243
应收票据及应收账款	363	681	696	970	2,727	3,141
商品及产品	142	396	376	346	361	463
固定资产	248	508	4,064	5,845	5,333	4,843
有形固定资产	233	461	3,918	5,667	5,152	4,674
无形固定资产	7	19	15	29	23	19
投资其他资产	8	27	130	148	158	149
资产合计	994	2,320	6,823	9,737	10,859	12,468
负债部分						
流动负债	391	960	2,292	2,295	3,000	3,384
应付票据及应付账款	116	138	151	186	283	398
有息负债	17	136	827	1,216	1,537	1,275
固定负债	478	709	2,934	4,798	4,317	3,291
长期借款	426	615	2,925	4,079	3,620	2,767
负债合计	869	1,670	5,227	7,093	7,317	6,676
净资产部分						
净资产	124	649	1,596	2,644	3,541	5,792
负债与净资产合计	994	2,320	6,823	9,737	10,859	12,468

*单独决算

本资料中记载的内容，是在一般认为的经济形势和本公司认为合理的一定前提下制作的，若因外部经营环境的变化而更改，恕不提前通知。

在本次发布时获得的资料和信息当中，包括“预测信息”。这些信息是根据现在的估计、预测以及带有风险的假设得出的，含有不确定性，也许与实际结果相左。

即使今后出现新的信息、事情等，本公司也不承担更新和修正本次发布所含的“预测信息”的义务。